

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成22年11月4日(2010.11.4)

【公開番号】特開2007-184485(P2007-184485A)

【公開日】平成19年7月19日(2007.7.19)

【年通号数】公開・登録公報2007-027

【出願番号】特願2006-2671(P2006-2671)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/60 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/60 3 1 1 T

【手続補正書】

【提出日】平成22年9月16日(2010.9.16)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】電子部品実装装置、電子部品実装方法及び電子部品装置

【手続補正 2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板上に接着剤を塗布してこの接着剤上に電子部品を搭載し、この電子部品上に接着剤を塗布してこの接着剤上に補強板を搭載する電子部品実装装置において、

前記基板上及び前記電子部品上への接着剤の塗布を所定位置で行なう塗布手段と、

前記電子部品及び前記補強板の搭載を所定位置で行なう搭載手段と、

この搭載手段によって前記電子部品及び補強板が搭載された前記基板を加熱位置に搬送する搬送手段と、

この搬送手段によって加熱位置に搬送された前記基板上の前記電子部品、及び前記補強板を加熱して接着する接着手段と

を具備することを特徴とする電子部品実装装置。

【請求項 2】

基板上の複数個所に順次接着剤を塗布してこれら接着剤上に電子部品を順次搭載し、これら電子部品上に順次接着剤を塗布してこれら接着剤上に補強板を順次搭載する電子部品実装装置において、

前記基板上の複数個所、及び前記複数の電子部品上への接着剤の塗布を所定位置で行なう塗布手段と、

前記複数の電子部品及び前記複数の補強板の搭載を所定位置で行なう搭載手段と、

この搭載手段によって前記複数の電子部品及び前記複数の補強板が搭載された前記基板を加熱位置に搬送する搬送手段と、

この搬送手段によって加熱位置に搬送された前記基板上の前記複数の電子部品、及び前記複数の補強板を加熱して接着する接着手段と

を具備することを特徴とする電子部品実装装置。

【請求項 3】

前記基板上の複数個所への接着剤の塗布が全て終了する前に前記搭載手段による前記電子部品の搭載を開始し、前記複数の電子部品への接着剤の塗布が全て終了する前に前記搭載手段による前記補強板の搭載を開始することを特徴とする請求項２記載の電子部品実装装置。

【請求項４】

基板上の複数個所に順次接着剤を塗布してこれら接着剤上に電子部品を順次搭載する電子部品実装装置において、

前記基板上の複数個所への接着剤の塗布を所定位置で行なう塗布手段と、

前記複数の電子部品の搭載を所定位置で行なう搭載手段と、

この搭載手段によって前記複数の電子部品が搭載された前記基板を加熱位置に搬送する搬送手段と、

この搬送手段によって加熱位置に搬送された前記基板上の複数の前記電子部品を加熱して接着する接着手段と

を具備することを特徴とする電子部品実装装置。

【請求項５】

前記基板上の複数個所への接着剤の塗布が全て終了する前に前記搭載手段による前記電子部品の搭載を開始することを特徴とする請求項４記載の電子部品実装装置。

【請求項６】

基板上に接着剤を塗布することと、

前記塗布された接着剤上に電子部品を搭載することと、

前記搭載された電子部品上に接着剤を塗布することと、

この塗布された接着剤上に補強板を搭載することと、

前記電子部品及び前記補強板が搭載された前記基板を加熱位置に搬送することと、

前記加熱位置に搬送された前記基板上の前記電子部品、及び前記補強板を加熱して接着することとを具備し、

前記基板上及び前記電子部品上への接着剤の塗布、さらに、前記電子部品及び前記補強板の搭載を同じ位置で行なうことを特徴とする電子部品実装方法。

【請求項７】

基板上の複数個所に順次、接着剤を塗布することと、

前記塗布された複数個所の接着剤上に順次、電子部品を搭載することと、

前記搭載された複数個の電子部品上に順次、接着剤を塗布することと、

前記複数の電子部品上に塗布された接着剤上に順次、補強板を搭載することと、

前記複数の電子部品、及び前記複数の補強板が搭載された前記基板を加熱位置に搬送することと、

前記加熱位置に搬送された前記基板上の前記複数の電子部品、及び前記複数の補強板を加熱して接着することとを具備し、

前記基板上の複数個所、及び前記複数の電子部品上への接着剤の塗布、さらに、前記複数の電子部品、及び前記複数の補強板の搭載を同一位置で行なうことを特徴とする電子部品実装方法。

【請求項８】

基板上の複数個所に順次、接着剤を塗布することと、

前記塗布された複数個所の接着剤上に電子部品を順次、搭載することと、

前記複数の電子部品が搭載された前記基板を加熱位置に搬送することと、

前記加熱位置に搬送された前記基板上の複数の電子部品を加熱して接着することとを具備し、

前記基板上の複数個所への接着剤の塗布、及び前記複数の電子部品の搭載を同一位置で行なうことを特徴とする電子部品実装方法。

【請求項９】

前記請求項６記載の実装方法によって実装されたことを特徴とする電子部品装置。

【請求項１０】

前記請求項 7 記載の実装方法によって実装されたことを特徴とする電子部品装置。

【請求項 11】

前記請求項 8 記載の実装方法によって実装されたことを特徴とする電子部品装置。